

格科微有限公司

关于高像素图像传感器产品出货情况的自愿性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 截至公告发布日，本年度格科微有限公司（以下简称“公司”）3,200万及5,000万像素图像传感器产品已累计实现出货超1亿颗。
- 公司高像素产品的持续放量，充分证明公司高像素单芯片集成技术得到市场验证与认可，对公司未来的发展将产生积极的影响。
- 公司于近日收到国际知名品牌原始设备制造商（ODM）订单，供应0.7微米规格5,000万像素图像传感器产品，已实现部分出货。

一、高像素图像传感器产品出货量及订单情况

今年以来，公司3,200万及5,000万像素图像传感器出货量持续提升，推动公司高像素产品收入持续增长，在手机CIS业务营收占比进一步提升。截至公告发布日，本年度公司3,200万及5,000万像素图像传感器产品已累计实现出货超1亿颗，其中5,000万像素产品包含0.61微米、0.7微米、1.0微米等多个规格，被广泛应用于多个品牌客户机型的前后主摄。

同时，公司持续推动单芯片高像素产品在更多品牌客户导入、出货及量产。近日，公司收到国际知名品牌ODM订单，并已实现部分出货。公司本次供应0.7

微米规格5,000万像素图像传感器产品，该产品基于GalaxyCell®2.0工艺平台，在像素性能、动态范围及功耗优化方面实现了显著提升，并将相位对焦（PDAF）密度提升至100%，全面增强自动对焦能力，提升拍摄精度和速度。该产品搭载公司自研的DAG HDR技术，能够输出12bit图像数据，使图像中的高光与阴影层次丰富、细节生动；同时搭载常开低功耗（AON）技术，支持超低功耗（ULP）模式和环境光检测（ALS）模式，满足差异化模式的需求。

二、对公司的影响

公司0.7微米5,000万像素图像传感器产品收到国际知名品牌ODM订单以及高像素产品出货量的持续提升，充分证明公司创新的高像素单芯片集成技术及相关产品得到市场验证与认可，也充分验证了公司Fab-Lite模式的高效性。目前，公司基于单芯片集成技术，已相继实现0.7微米、1.0微米及0.61微米规格的5,000万像素图像传感器产品量产。后续公司将基于该技术平台进一步迭代3,200万及5,000万等高像素产品性能，同时推出1亿像素以上更高规格产品，不断增强公司的核心竞争力，提升市场份额、扩大领先优势。

三、相关风险提示

1、以上订单受具体执行、实施进度等因素影响，对公司当期和未来年度的业绩影响存在不确定性；在履行过程中如果遇到不可抗力等因素的影响，部分订单可能会存在部分或全部无法履行或终止的风险。

2、以上高像素图像传感器产品出货量数据源自公司内部统计，未经审计，不能以此直接推算公司全年营业收入、净利润等财务数据，仅供投资者及时了解公司日常经营概况。具体准确的财务数据以公司正式披露的定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

格科微有限公司董事会

2025年12月5日